

微電腦雙溫冷凍切片機



冷凍切片是利用低溫方式使組織結凍，因而增加組織之硬度，以提供切片時所需之支撐性，因此冷凍切片機需經常維持於低溫操作環境。同時藉由低溫冷凍方式，一方面可以縮短組織處理之流程與時間，並可在不使用化學固定液處理的條件下，得以保存細胞內生化活性或抗原性之完整，以提供並符合研究或臨床診斷上特殊之要求與需求。

儀器設備說明

- 機型：LEICA CM1950
- 切片厚度設定：1~100 μm
- 冷凍操作室溫度設定：0°C ~ -35°C
- 二種粗修片功能模式：(1)固定值選取模式 10~40 μm (2)任意值選取模式 1~600 μm
- 標本包埋座具 17 個標本載台放置處，具數字標示功能。

- 電腦控制標本座頭電動前進與後退，且各有二種不同速度，附 LED 警示裝置。
- 冷凍操作室、標本夾頭與標本包埋座均可手動除霜。
- 冷凍操作室具微電腦控制自動除霜功能，每 24 小時自動除霜一次。
- 標本頭具自動回縮功能，可自動回縮 20 μ m 或可設定 off 關閉。
- 具功能鎖定鍵，可防止設定數值被任意改變。
- 使用寬 70mm $\pm$ 1mm 四面可使用之抗靜電玻璃防捲片。
- 標本頭具急速冷凍降溫功能，溫度設定範圍：-10 $^{\circ}$ C ~ - 50 $^{\circ}$ C。

服務項目

- 檢體樣本：各種生物組織
- 冷凍切片：各種組織切片後，需做 HE、IHC、各式免疫組織化學染色之處理

注意事項

- 在使用完畢或一個階段完成時，需把刀座保護擋片擺放或取下刀片
- 在使用完畢或一個階段完成時，需把手轉輪固定鎖鈕鎖上
- 機器使用完畢後，需做基本清潔
- 機器使用完畢後，刀片固定鎖鈕需放鬆不要鎖緊，以免彈性疲乏
- 機器使用完畢後，使用標本頭電動後退鍵將標本頭退回原點
- 機器使用完畢後，需將操作艙溫度調至-20 $^{\circ}$ C待機使用
- 使用本機器需自備刀片、冷凍包埋液與玻片等相關耗材
- 經認證許可資格者，在無事先預約實驗時段情況下，自行操作機台，並導致機台嚴重故障或是損毀，經發現其行為者，立即取消該預約者認證資格，並不得再考取認證資格。

- 在無認證資格情況下，任意操作機台者，經發現其行為者，立即取消該預約者預約權半年。
- 若因人為操作不當，導致機台故障，累計 2 次以上，立即取消該預約者認證資格，並暫停該預約者 1 個月預約權。經 1 個月後，需再次認證，經認證通過才給發操作執照。
- 若因人為操作不當，導致機台嚴重故障或是損毀，立即取消該預約者認證資格，並暫停該預約者半年預約權。經半年後，需再次認證，經認證通過才給發操作執照。

實驗室負責人及聯絡人資訊

	姓名	職稱	單位	分機/手機	e-mail
負責教授/ 聯絡人	孫羽佑	助理教授	生藥所	#7205 0978134478	yuyosun@mail.nsysu.edu.tw